



福懋科技股份有限公司
FORMOSA ADVANCED THCHNOLOGIES CO., LTD

2024年 Q3 法人說明會



FATC 記憶體最佳代工夥伴

總經理暨發言人 張憲正 || 2024年11月28日

免責聲明

簡報內容（含本會議中所揭露之資訊）含有若干預測性資訊，僅供參考之用。福懋科技股份有限公司或任何第三人均不就該預測性資訊之正確性與完整性承擔任何責任，亦不負更新或更正該資訊之義務，請您務必謹慎審閱以上資訊。如未經許可，亦請您切勿散播重製或揭露以上資訊之一部分或全部予第三人。



會議議程

- 1 2024年第3季營運績效及財務狀況
- 2 研究發展與規劃
- 3 營運重點與市場展望
- 4 問與答



福懋科技股份有限公司
FORMOSA ADVANCED THCHNOLOGIES CO., LTD



2024年第3季 營運績效及 財務狀況

2024年第3季財務摘要

單位:新台幣千元

項目	2024年第3季		2024年第2季		較上季差異		2023年第3季		較去年同期差異	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
會計科目										
營業收入	2,080,389	100.0	2,337,549	100.0	-257,160	-11.0	1,641,108	100.0	439,281	26.8
營業毛利	201,451	9.7	382,958	16.4	-181,507	-47.4	788	0.0	200,663	25,464.8
營業利益	102,612	4.9	289,964	12.4	-187,352	-64.6	-73,080	-4.5	175,692	-
稅前息前折舊攤銷前利益	366,198	17.6	601,316	25.7	-235,118	-39.1	342,115	20.8	24,083	7.0
營業外收入(支出)	41,011	2.0	54,323	2.3	-13,312	-24.5	127,798	7.8	-86,787	-67.9
所得稅利益(費用)	-21,410	-1.0	-60,814	-2.6	39,404	-	-10,953	-0.7	-10,457	-
本期淨利	122,213	5.9	283,473	12.1	-161,260	-56.9	43,765	2.7	78,448	179.2
每股盈餘(元)	0.28		0.64		-0.36		0.10		0.18	
每股淨值(元)	25.73		26.24		-0.51		26.44		-0.71	

2024年第3季綜合損益表

單位:新台幣千元

項目	2024年第3季		2024年第2季		較上季差異		2023年第3季		較去年同期差異	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
會計科目	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
營業收入	2,080,389	100.0	2,337,549	100.0	-257,160	-11.0	1,641,108	100.0	439,281	26.8
營業成本	1,878,938	90.3	1,954,591	83.6	-75,653	-3.9	1,640,320	100.0	238,618	14.5
營業毛利	201,451	9.7	382,958	16.4	-181,507	-47.4	788	0.0	200,663	25,464.8
銷管費用	29,307	1.4	27,979	1.2	1,328	4.7	31,353	1.9	-2,046	-6.5
研發費用	69,532	3.3	65,015	2.8	4,517	6.9	42,515	2.6	27,017	63.5
營業利益	102,612	4.9	289,964	12.4	-187,352	-64.6	-73,080	-4.5	175,692	-
業外收入(支出)	41,011	2.0	54,323	2.3	-13,312	-24.5	127,798	7.8	-86,787	-67.9
稅前淨利	143,623	6.9	344,287	14.7	-200,664	-58.3	54,718	3.3	88,905	162.5
所得稅利益(費用)	-21,410	-1.0	-60,814	-2.6	39,404	-	-10,953	-0.7	-10,457	-
本期淨利	122,213	5.9	283,473	12.1	-161,260	-56.9	43,765	2.7	78,448	179.2
每股盈餘(元)	0.28		0.64		-0.36		0.10		0.18	
每股淨值(元)	25.73		26.24		-0.51		26.44		-0.71	

2024年第3季與2024年第2季差異說明

單位:新台幣千元

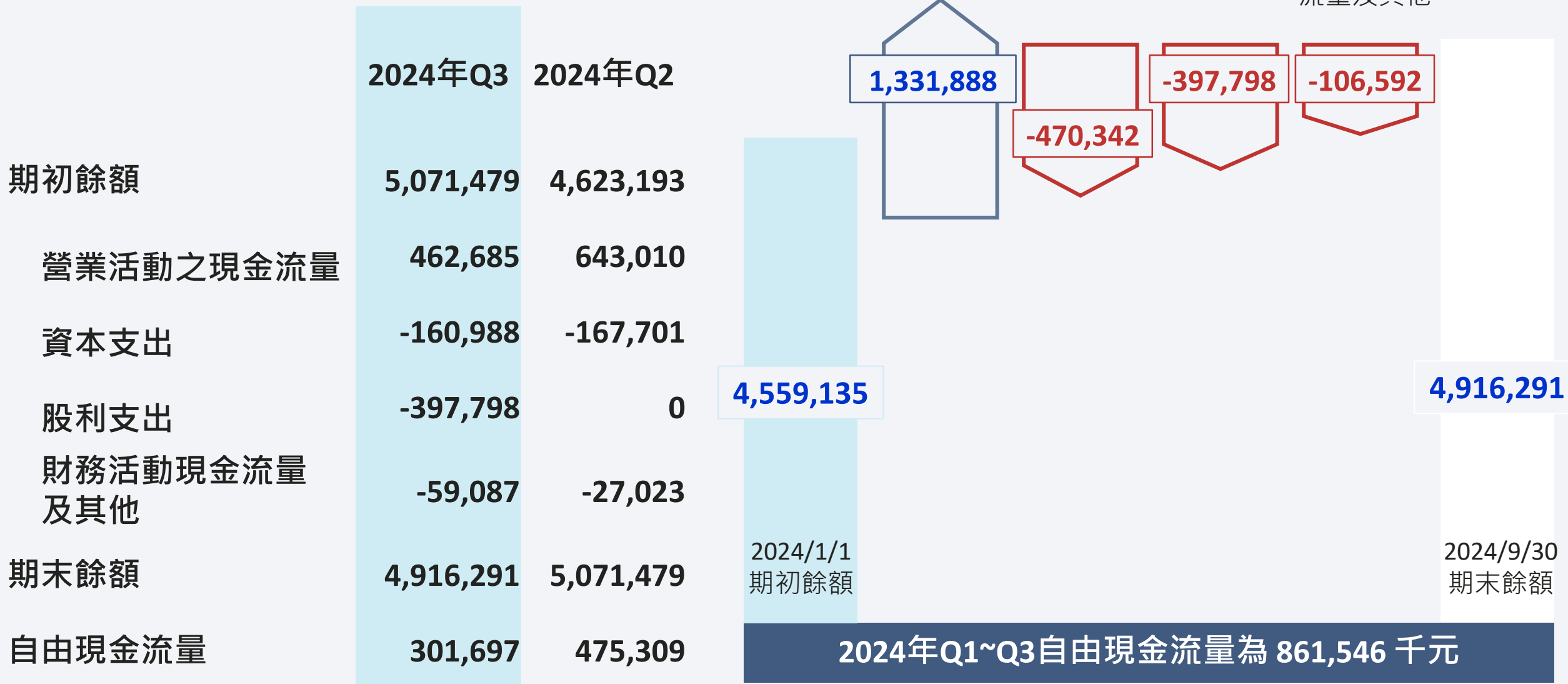
會計科目	2024年Q3		2024年Q2		差異		差異說明
	金額	%	金額	%	金額	%	
營業收入	2,080,389	100.0	2,337,549	100.0	-257,160	-11.0	營收減少主要因為銷售量減少。
營業毛利	201,451	9.7	382,958	16.4	-181,507	-47.4	2024年Q3毛利季減47.4%，主要為銷售量減少。
營業費用	98,839	4.8	92,994	4.0	5,845	6.3	2024年Q3營業費用季增5,845千元，主要為推銷管理費用增加1,328千元及研發費用增加4,517千元。
營業利益	102,612	4.9	289,964	12.4	-187,352	-64.6	2024年Q3營業利益季減187,352千元，主要為毛利減少181,507千元、營業費用增加5,845千元。
本期淨利	122,213	5.9	283,473	12.1	-161,260	-56.9	本期淨利季減161,260千元，主要為營業利益減少187,352千元、其他收入增加56,119千元、兌換損失增加71,367千元及所得稅費用減少39,404千元。



2024年Q1~Q3現金流量

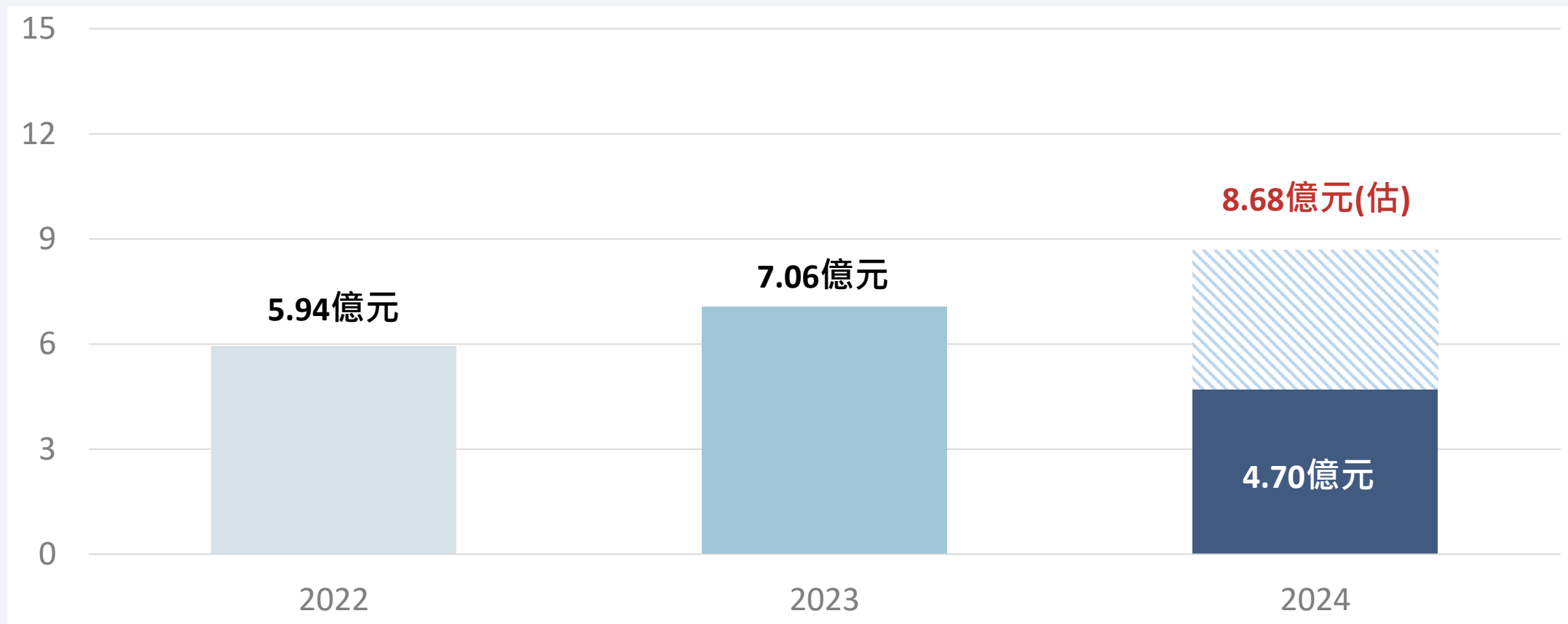
現金流量表

單位:新台幣千元



歷年資本支出

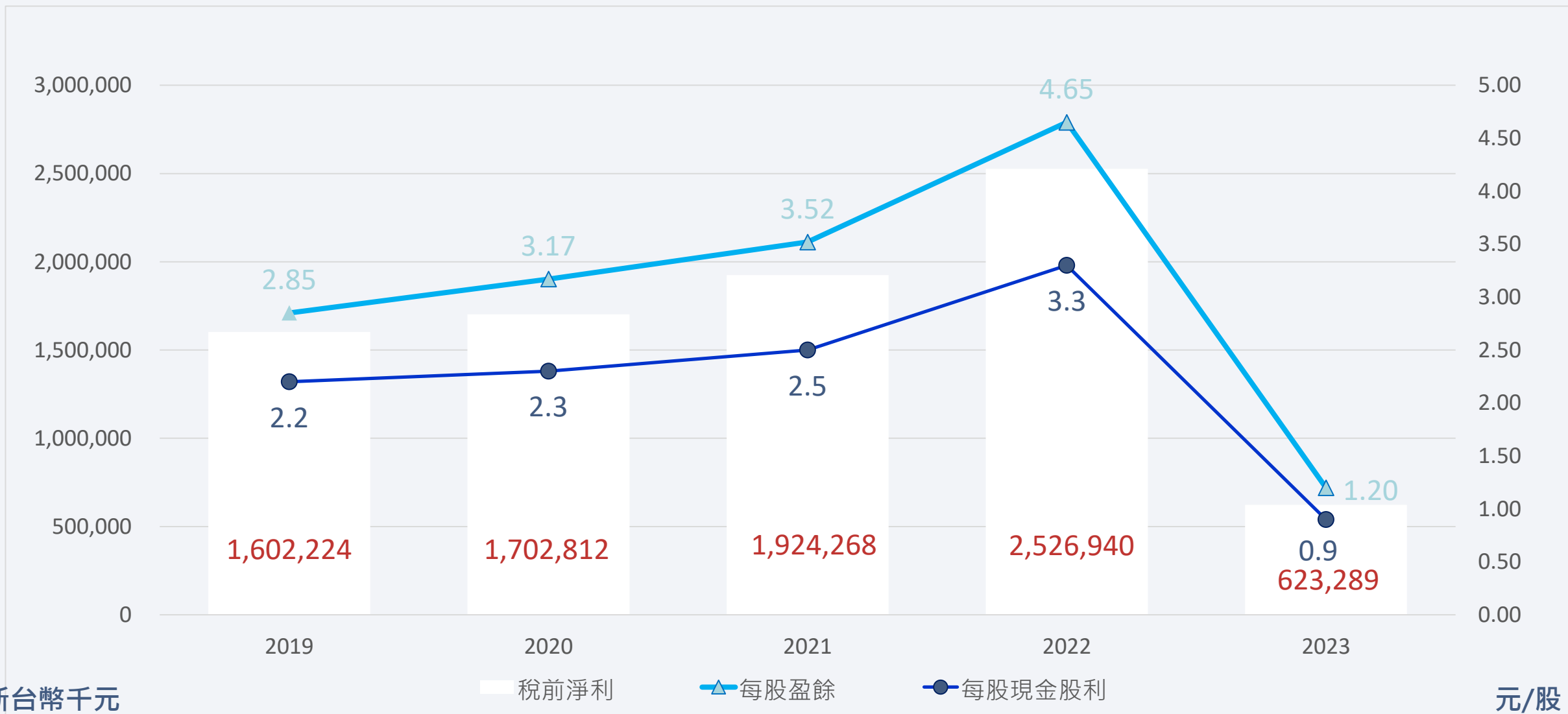
單位:新台幣億元



- 2024年前三季實際資本支出為 4.70億元。
- 2024年度全年預估資本支出為新台幣 8.68億元。

近5年之稅前淨利、稅後EPS、現金股利

單位:新台幣千元



新台幣千元

元/股



福懋科技股份有限公司
FORMOSA ADVANCED THCHNOLOGIES CO., LTD

2



研究發展 與規劃

研究發展與規劃

晶圓凸塊、矽穿孔露銅及多層堆疊技術開發：

1

隨著終端產品體積越來越小，低耗能及高速運算能力要求更高，除現有覆晶封裝外，並開發晶圓凸塊(Bumping)及重新佈線(RDL)技術。

2

因應高頻寬記憶體(HBM)低耗能、高容量及高速度產品發展趨勢，開發3D矽穿孔露銅(3D TSV Reveal)製程技術，佈局先進封裝領域。

3

因應產品高容量需求，已開發出9層晶片堆疊之鐳線能力，使晶片多層堆疊技術進入新的里程碑。



福懋科技股份有限公司
FORMOSA ADVANCED THCHNOLOGIES CO., LTD

3



營運重點
與
市場展望

營運重點

1

因應記憶體產品朝高速高容量發展，持續進行先進封裝、測試及模組製程技術開發。

2

配合客戶開發導入量產DDR5產品及十奈米級產品。

3

持續進行新建五廠工程，預計明年年中完工。

市場展望

1

2024年除AI相關應用需求較強勁外，一般DDR3/DDR4常規記憶體產品受全球經濟景氣不佳影響，手機、PC及各類消費性電子產品需求不振，整體記憶體需求轉弱，庫存去化緩慢，IC封測代工需求短期仍呈保守。

2

一般PC與NB市場需求疲弱，對於標準型記憶體模組代工需求轉趨保守。電競記憶體模組則在高階產品轉換帶動下需求漸增。本公司致力於縮短生產交期，以符合客戶需求。第四季為電競記憶體模組市場傳統旺季，搭配DDR5比重提升，帶動換機需求，預期模組代工需求將成長。



福懋科技股份有限公司
FORMOSA ADVANCED THCHNOLOGIES CO., LTD

4



問與答